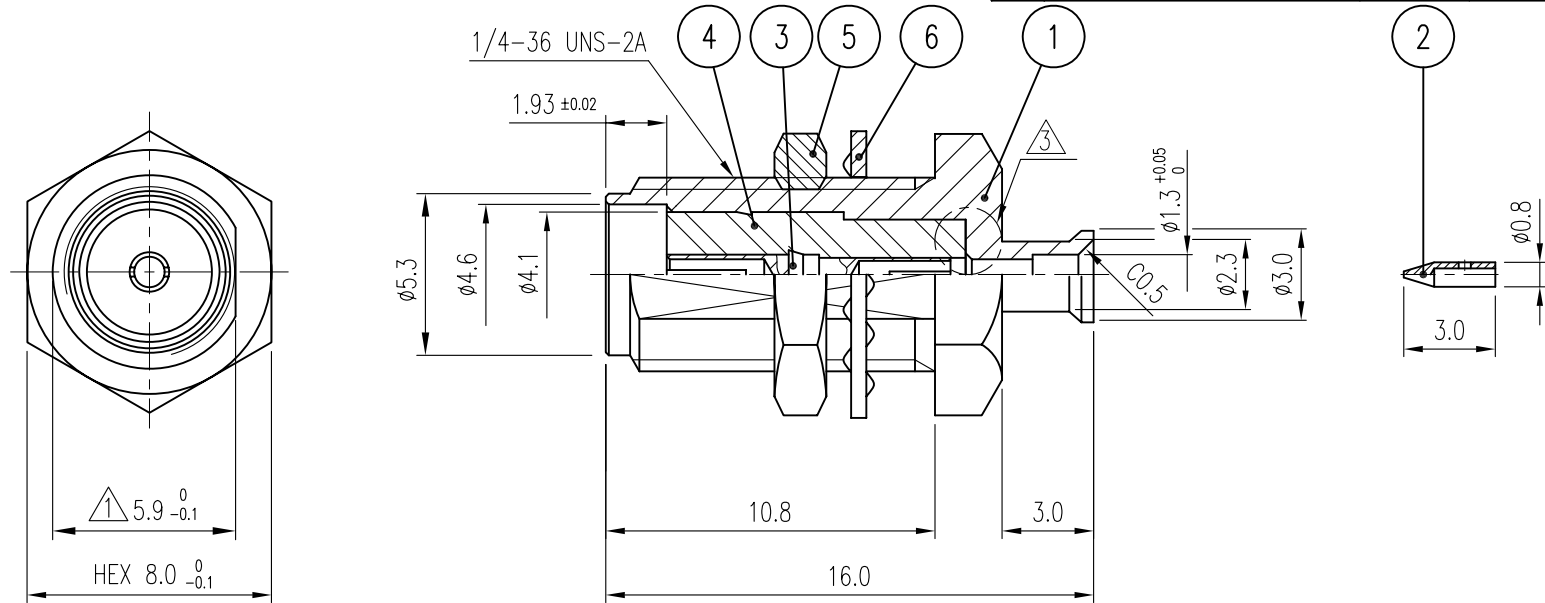


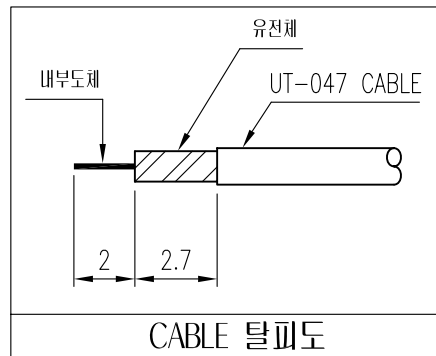
수 정 내 용									
부호	내 용	수정자	승인자	년 월 일					
1	6.0 --> 5.9로 변경	임채희	안병호	2004. 3. 12.					
2	업체요구[질면2005-235] (코팅 위치 및 크기 값에 적용)	임채희	안병호	2004. 3. 12.					
3	[질면No.연구2006-129] 진퇴장 향상 내지압 불량 관련 BODY 면취추가	김인철	윤상진	2006. 6. 9.					
4	[질면처리No.201301-0007] 기타 BODY 남시바늘 추가 및 편 내경 관련 공차 변경	김인철	김인철	2013. 1. 11.					



*포장사양 2페이지 참조

주 기

- 절연체에 편 조립전, ②③PIN Mating 전수 검사 실시하여 이상없을 시 조립 진행 할 것



6	WASHER	1	BsS	Gold Plate	DWA00005-5/1
5	NUT	1	MBsBD	Gold Plate	DNT00025-5/1
4	INSULATOR	1	TEFLON		DIN00248-N/1
3	CONTACT	1	BeCu	Gold Plate	DCT00146-5/3 DCT00146-5/2
2	CONTACT	1	MBsBD	Gold Plate	DCT01457-5/1
1	BODY	1	MBsBD	Gold Plate	DBD00179-5/2 DBD00179-5/1
품번	품 명	수량	재 질	표면처리	비 고

비제가능재질	년월일	2013. 01. 13.	 RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017		
공통공차 * ±0.1 ** ±0.05	승인	I. C. KIM			
재질	검도	E. H. KIM	도명 SMA50 CABLE JB (F/N) 47		
열처리	제도	I. C. KIM			
보호피막처리	작성부서	연 구 소	A4도번 CN01053-7/2		
	적도	4/1 단위 mm 중량			

